

**中信证券股份有限公司**  
**关于龙芯中科技术股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2026 年 5 月 14 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、股东会和董事会议事规则等公司治理制度、股东会和董事会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2025 年度内部控制自我评价报告、2025 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其控股股东、实际控制人、董事、审计委员会委员、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### (一) 业绩大幅下滑或亏损的风险

集成电路设计企业的经营业绩受下游市场波动影响较大。如果公司不能及时提供满足市场需求的产品和服务，或下游市场需求发生重大不利变化，公司可能面临业绩下滑的风险。政策性相关业务受相关政策及市场波动影响较大，当需求大幅降低或延后时，公司将面临业绩下滑的风险。

报告期内，公司按照《企业会计准则第 8 号资产减值》和公司相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备，影响了报告期内的净利润，加大了公司报告期内的亏损。

### (二) 核心竞争力风险

#### 1、研发不达预期风险

芯片行业发展迅速，芯片产品更新换代快，如果公司未能紧跟市场需求，正

确把握核心技术研发方向，导致研发技术定位偏差或技术迭代落后市场，可能致使产品难以满足市场需求，公司将面临成本资源浪费、市场份额减小及竞争力下降的风险。

芯片研发周期长、投入大，技术复杂度高，尤其是基于先进工艺的芯片设计所需的人力、财力和物力投入不断攀升，稍有不慎可能导致流片失败或产品开发失败，将为公司带来经营业绩下滑的风险。

## 2、知识产权风险

公司致力于建立自主信息技术体系和产业生态，公司始终坚持自主创新，经过多年积累，已构建自主研发、系统布局、生态开放、积极防御的自主知识产权保护体系并积累丰富的自主知识产权成果。随着公司所从事的处理器及配套芯片设计业务不断拓展，公司面临的知识产权风险日益多元化和复杂化，可能体现在对核心技术的知识产权保护方面、权利边界理解偏差而引发法律争议的风险，以及不同司法管辖区域在法律适用、权利有效性认定及执行标准上存在差异导致的合规风险或潜在法律纠纷的风险等，上述风险可能会对公司声誉、技术研发及市场拓展造成不利影响，进而对公司的业务和经营产生负面影响。

## 3、核心技术人才流失风险

作为技术密集型行业，核心技术人才是长期持续发展的关键。公司在长期自主研发和产业建设过程中团结了大量掌握 CPU 设计和 OS 开发的技术人才。如果由于未能持续加强对团队的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，以及未能持续加强对技术人才的激励和保护力度，存在技术人才流失和技术流失，或者无法吸引更多优秀技术人才加入的风险，可能会对公司技术研发能力和经营造成不利影响。

### （三）供应商集中的风险

公司采用 Fabless 经营模式，主要专注于芯片设计环节，生产性采购内容涵盖芯片加工服务及电子元器件等原材料，主要通过外部供应商完成。报告期内，公司从前五大供应商的采购金额合计占全部采购金额比例为 58.45%，主力芯片产品的加工服务仍依赖核心供应商提供，供应商集中度处于高位。鉴于部分供应

商的技术壁垒较高，所提供服务具有专属性，如果公司与核心供应商的合作关系波动，且公司未能及时拓展替代资源，将可能对公司生产经营、研发造成不利影响。

#### **（四）财务风险**

##### **1、应收账款导致的坏账风险**

报告期末，公司的应收账款账面价值为 4.71 亿元，占报告期末资产总额的比例为 14.89%，较高的应收账款占用了公司资金，加大了公司的经营风险。虽然公司按照《企业会计准则第 8 号资产减值》和公司相关会计政策的规定计提了 2.08 亿元（截至 2025 年 12 月 31 日）的坏账准备，但若宏观经济形势恶化或者客户自身财务状况出现不利变化，公司可能面临应收账款逾期和无法全额收回的风险，从而对公司的财务状况、经营成果和现金流造成不利影响。

##### **2、存货跌价风险**

公司根据已有客户订单需求以及对市场未来需求的预测制定采购和生产计划。报告期末，公司的存货账面价值为 8.50 亿元，占报告期末资产总额的比例为 26.89%。虽然公司按照会计政策计提了 2.43 亿元（截至 2025 年 12 月 31 日）的存货跌价准备，但公司依然可能面临因市场环境发生不利变化而出现存货跌价减值的风险，进而影响公司的经营业绩。

##### **3、研发投入相关的风险**

作为技术密集型企业，公司坚持核心技术自主创新的发展战略，持续维持高强度的研发投入，报告期内研发投入总额 5.07 亿元，占报告期内营业收入的比例为 79.75%，部分研发投入形成了开发支出，后续将转入无形资产。若公司研究成果的产业化应用不及预期以及公司持续高强度的研发投入，可能对公司的经营成果产生不利影响。

#### **（五）行业风险**

##### **1、市场竞争风险**

公司致力于打造独立于 X86 体系与 ARM 体系之外的第三套生态系统，可能

引起竞争对手的高度重视，使得行业竞争加剧。公司面临市场竞争加剧的风险。

公司基于信息系统和工控系统两条主线开展产业生态建设，产品主要应用于关键信息基础设施自主化领域。而国际上 CPU 商用市场基本被 Intel、AMD 等大公司掌控，移动平台领域 ARM 生态体系占主导地位，国内市场也有多个竞争对手入局，在竞争对手成熟的软硬件壁垒下，如果公司在提高性价比、完善软件生态、重构产业链上未制定有效的或根据市场变化调整相应的竞争策略，可能在激烈的行业竞争中处于不利地位。

## **2、需求波动风险**

芯片市场竞争激烈，技术快速迭代，市场需求高度波动而难以预测，如客户技术路线调整、终端产品需求预测失准、现有产品市场收缩等，可能会导致公司芯片产品的市场实际需求落后于预期、已有市场存量减小等，进而引发特定型号芯片库存积压、销售收入下降及前期研发投入难以回收的风险。

## **3、生产成本上涨或供货周期延长风险**

随着国际政治经济局势剧烈变动，以及美西方不断制约高科技半导体企业的先进制造工艺，核心供应商的先进制造产能紧张可能会出现进一步加剧的局面，公司将面临采购价格上涨或供货周期延长的风险，对公司生产经营产生一定的不利影响。

## **（六）宏观环境风险**

公司所处的集成电路产业深受全球地缘政治格局与宏观经济周期的双重影响，国际贸易参与主体持续调整其出口管制与技术封锁政策，针对半导体材料、半导体设备、EDA 工具、制造工艺、封装、测试等领域的管制限制不断升级，贸易保护主义抬头，关税政策反复无常，都给全球半导体市场和供应链安全稳定带来不确定风险。可能对公司的生产经营造成不利影响。

## **四、重大违规事项**

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

## **五、主要财务指标的变动原因及合理性**

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	63,532.06	50,425.72	25.99
归属于上市公司股东的净利润	-45,514.03	-62,534.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,826.76	-66,472.53	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-34,789.27	-33,501.01	不适用
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	250,658.31	293,639.71	-14.64
总资产	316,187.09	349,748.34	-9.60
主要财务指标	2025 年末	2024 年末	本期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	-1.14	-1.56	不适用
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.14	-1.56	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-1.27	-1.66	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-16.73	-19.29	增加了2.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-18.68	-20.50	增加了1.82个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	79.75	105.34	减少25.59个百分点

2025 年公司营业收入提升 25.99%，主要原因是 2022-2024 年研发转型成果逐步推向市场，新产品竞争力提升；新一轮党政办公市场重启、安全应用市场恢复发展给公司带来新的商机，公司积极开拓非政策性市场，取得有效进展。

2025 年毛利率 47.06%，比 2024 年的 31.04%提高 16.02 个百分点，主要原因是安全应用市场的恢复带来的高质量等级芯片销售增加、降本桥片产品四季度开始出货、对外芯片技术授权带来新的营收等。

2025 年净利润-4.55 亿元，同比减亏 1.70 亿元，主要原因是毛利润从 2024 年的 1.57 亿元增加至 2025 年的 2.99 亿元，公司加强应收账款管理和客户信用

管理，安全应用和工控业务消耗了部分长库龄的库存，减值损失快速收窄。

报告期内，公司加大应收账款的催款力度，销售商品、提供劳务收到的现金 6.52 亿元，同比增加 1.66 亿元；购买商品接受劳务支付的现金为 6.05 亿元，同比增加 2.06 亿元。

研发投入合计 5.07 亿元，同比减少 4.61%；其占营业收入的比例较上年同期减少 25.59 个百分点，主要系收入规模增长所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）公司的核心竞争力

#### 1、长期坚持自主研发形成的技术和能力积累

公司是国内唯一坚持基于自主指令系统构建独立于 X86 体系和 ARM 体系的开放性信息技术体系和产业生态的 CPU 企业。经过长期积累，形成了自主 CPU 研发和软件生态建设的体系化关键核心技术积累。

与国内多数集成电路设计企业购买商业 IP 进行芯片设计不同，龙芯中科坚持自主研发核心 IP，形成了包括系列化 CPUIP 核、GPUIP 核、内存控制器及 PHY、高速总线控制器及 PHY 等上百种 IP 核。报告期内，通过新一代 CPU、SoC 和桥片等芯片项目研制的牵引，持续演进高性能 CPU 核、高能效 GPGPU 核、安全密码处理器核、高带宽低延迟片间互连龙链接口、高速内存接口和高速 IO 接口的设计研发能力。

与国内多数 CPU 企业主要基于 X86 或者 ARM 指令系统融入已有的国外信息技术体系不同，公司推出了自主指令系统 LA，并基于 LA 迁移或研发了操作系统的核心组件，包括内核、编译器、虚拟机、浏览器、媒体播放器等。形成了面向服务器、面向桌面和面向工控类应用的基础版操作系统。在报告期内，常态化维护和优化龙架构开源软件生态。推动和支持操作系统社区龙架构版本的发展和演进。结合龙芯新研的 CPU、GPGPU、桥片等芯片，对开源软件社区的龙架构版本进行持续完善和优化。基于龙架构和龙芯 GPGPU，持续完善图形、算力和 AI 软件生态。持续提高二进制翻译系统的兼容性和性能。针对市场需求，研制了浏览器兼容解决方案，实现了对各类插件和外设的支持，基本解决主要业务

领域存量网页应用的兼容问题。研制了外设驱动引擎，实现了对打印机、扫描仪、高拍仪等设备驱动的支持，系统解决 Linux 生态的外设驱动问题。

与国内多数 CPU 设计企业主要依靠先进工艺提升性能不同，公司通过设计优化和先进工艺提升性能，摆脱对最先进工艺的依赖。通过自主设计 IP 核，克服境内工艺 IP 核不足的短板，增强工艺选择的自由度。报告期内，针对 CPU、SoC 和桥片等不同类型芯片的设计需求，在多个工艺节点下持续扩展 IP 支持，自研了包括 LCL、PCIe、SATA、USB、DP/eDP 等高速 SerDesPHY，以及 PLL、LDO 等时钟和电源 IP；基于高自主可控工艺线开展多款芯片的迁移和验证工作取得决定性进展，大大提高了供应链的韧性。

上述在长期自主研发和产业化过程中形成的核心技术和能力积累使得公司可以在现有技术基础上快速升级迭代，提高产品性能和性价比，更好地满足客户定制化基础软硬件的需求，可以更好地建设自主信息产业生态。

## 2、自主生态优势明显

当前，建立独立于 X86 体系与 ARM 体系之外的第三套生态系统正成为业界的共识。一是发展新质生产力，摆脱传统经济增长方式和生产力发展路径，夯实我国信息产业“墙基”的需要；二是在美西方对中国集成电路产业的出口管制政策愈来愈严格的大背景下，作为产业核心竞争力的生态系统不能受制于人。LoongArch 以其自主性、先进性、兼容性的鲜明特征，正彰显出勃勃生机。公司也正致力于将自主指令系统优势转化为商业模式和软硬件生态方面的优势。

拥有自主指令系统的龙芯中科业务模式灵活丰富，包含众多系列的芯片销售及服务、IP 授权以及架构授权等。公司是国内 CPU 企业中极个别可以进行指令系统架构及 CPU IP 核授权的企业，报告期内开展龙架构 CPU 对外技术授权、支持合作伙伴研制基于龙芯 CPU 核心 IP 及龙架构指令系统的芯片产品；在高校推动龙架构人才生态建设，支持高校基于龙架构完成多款芯片流片；同时龙芯也是极个别在股权结构方面保持开放、未被整机厂商控制的 CPU 企业。

龙芯中科正在基于自主指令系统构建具有竞争力的生态体系，包括高性价比的通用及专用处理器芯片、外围配套芯片、具有韧性的软件生态和产业链。公司

通过持续的技术研发和创新，不断提升龙芯 CPU 的性能和能效，使其达到市场主流产品水平，并逐渐显现出性价比的优势。积极维护和发展龙架构的开源软件生态，开发完成与 X86、ARM 并列的 Linux 基础软件体系，基于龙架构的二进制翻译和算力框架基础软件生态建设取得突破性进展，龙架构 CPU 的软件生态壁垒得到实质性破解。产品竞争力的提升和软件生态的不断发展吸引着越来越多的软硬件开发商和合作伙伴加入龙架构生态，目前与公司开展合作的厂商达到上万家，下游开发人员达到数十万人，共同推动我国第三套信息技术体系和产业生态的建设。

### 3、团队优势

公司长期坚持“又红又专，红重于专”的人才选用和培养标准，在长期发展过程中锻造了一支有灵魂、有战斗力、能啃硬骨头的团队。龙芯团队坚持为“人民做龙芯”的根本宗旨，坚持自力更生、艰苦奋斗的工作作风，坚持实事求是的思想方法。在长期的研发和产业化实践中，团队在处理器研发、基础软件研发、结合客户需求的定制化开发等方面形成了深厚的技术积累。截至报告期末，公司员工中 59.47% 为研发技术人员，且研发技术人员中 53.36% 拥有硕士及以上学历，为公司持续的技术与产品创新提供重要的人才基础。

#### （二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	43,414.59	43,019.36	0.92
资本化研发投入	7,254.30	10,100.89	-28.18
研发投入合计	50,668.88	53,120.25	-4.61
研发投入总额占营业收入比例 (%)	79.75	105.34	减少 25.59 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	14.32	19.02	减少 4.70 个百分点

报告期内，公司持续保持较高水平的研发投入，本期研发投入总额占营业收入比例有所下降，主要系收入规模增长所致。

## （二）研发进展

### 1、在研项目情况

截至 2025 年末，公司在研项目的具体进展如下：

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
1	芯片研发项目 A	不适用	1.41	20,571.14	完成结项验收	面向服务器市场的高性能多核处理器芯片产品	国内先进水平
2	芯片研发项目 E	不适用	1,484.23	14,217.80	完成结项验收	面向桌面和终端市场的高性能处理器芯片产品	国内先进水平
3	芯片研发项目 B	不适用	1,602.35	7,295.15	推进多款工控 SoC 芯片产品的设计研发、初样验证、正样验证及产品化工作，其中 2K3000 流片成功并完成产品化工作	面向工控和终端市场研制具有市场竞争力的 SoC 芯片产品	国内先进水平
4	芯片研发项目 C	不适用	319.29	1,732.87	完成 3A6000 配套的新一代处理器桥片研发，有效降低了系统成本	适配龙芯系列处理器芯片，扩展出丰富的外围接口	国内先进水平
5	芯片研发项目 D	不适用	739.67	4,028.23	时钟芯片和 LDO 电源芯片实现规模销售；DCDC 电源芯片流片成功	适配龙芯 CPU 的模拟芯片	国内先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
6	芯片研发项目 H	不适用	449.56	2,863.67	进行多款 MCU 芯片的设计、验证和产品化工作,完成新款流量表芯片产品的初样验证和产品化主体工作,完成电机应用升级款芯片的产品化	结合市场应用,推出国内领先水平的 MCU 产品	国内先进水平
7	芯片研发项目 I	不适用	3,966.64	10,237.79	完成 16 核、32 核和 64 核高性能服务器 CPU 的产品化;完成基于成熟工艺的低成本服务器芯片流片,并开展产品化工作	面向服务器市场的高性能多核处理器芯片产品,在原有服务器芯片基础上改进片间互连,提升接口速率,大幅提高整体性能	国内先进水平
8	芯片研发项目 J	不适用	298.42	564.67	龙芯 2P0300 流片成功并推进产品化,已适配国内厂商多款机型开始小批量出货	面向打印机市场的系列化的主控 SoC 芯片产品	国内先进水平
9	关键核心技术研发项目 B	不适用	7,555.87	21,700.18	第二代 GPU 技术 LG200 在龙芯 2K3000 中完成硅验证,演进多个改进版本分别集成到不同芯片,均已完成交付	满足图形处理和通用计算的要求	国内先进水平
10	关键核心技术研发项目 C	不适用	1,435.78	14,039.30	片间互连接口及多品类高速 I/O 接口进行硅闭环的迭代改进	持续提高高速接口物理层传输速率,提高芯片间数据收发速度,并逐步拓	国内先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
						展高速接口协议兼容性	
11	关键核心技术研发项目 E	不适用	762.92	1,122.92	完成技术验收	进一步提高中高端处理器核的能效，重点在功耗的优化，达到市场同类型处理器核主流水平，给公司芯片产品提供核心竞争力支持	国内先进水平
12	关键核心技术研发项目 F	不适用	408.25	861.83	完成代码设计、功能验证和物理磨合和实现，即将交付流片	实现高性能、低功耗、高稳定性及良好扩展性的 DDR5 内存控制器，以满足未来计算需求	国内先进水平
13	关键核心技术研发项目 G	不适用	1,087.98	2,063.71	第五代高性能处理器核完成全面功能验证，完成物理磨合和实现，即将交付流片	实现更高性能处理核 IP，关注 IP 核的执行效率，在相同工艺下，性能较上一代进一步提升	国内先进水平
14	封装与测试技术研发	不适用	213.69	3,362.72	掌握打线类 QFN 封装及 BGA 封装工艺技术，初步建立高性能芯片的封装测试实验平台	建立高性能芯片的封装测试实验平台	国内先进水平
15	封装与测试技术研发二期建设	不适用	364.73	600.48	掌握基于小节距高可靠封装加固技术	实现小节距高可靠封装加固技术的研发	国内先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
16	操作系统基础软件研发	不适用	7,723.80	44,935.32	AlpineLinux 是云计算领域基础操作系统镜像, 报告期内发布的 3.22 和 3.23 两个版本实现了对龙架构的持续演进和优化; 开源软件世界有着重要影响力的 Debian 操作系统社区 2025 年 12 月 20 日正式宣布支持龙架构; 国内的 Alpine、OpenAnolis、OpenEuler、OpenCloud、OpenKylin、Deepin 等操作系统社区也都持续发布龙架构版本, 较为良好的支持龙芯最新的系列芯片; 研制发布了 Linux、开源鸿蒙、嵌入式三类操作系统的 LG200 系列 GPGPU 驱动, 实现了对主流图形编程标准的支持。研制了支持算力芯片的龙芯加速计算环境, 完成了对主要推理框架和常用模型的支持。研制了浏览器兼容解决方案, 实现了对各类插件和外设的支持, 基	龙芯开源软件生态得到进一步完善, 开源软件世界重要的操作系统社区发布龙架构的版本, 实现对最新一代龙芯 CPU 和桥片的支持	国内领先水平, 部分达到国际领先水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
					本解决主要业务领域存量网页应用的兼容问题。研制了外设驱动引擎，实现了对打印机、扫描仪、高拍仪等设备驱动的支持，破解了长期制约Linux桌面生态的外设驱动问题		
17	软件兼容性技术	不适用	230.86	230.86	用户态二进制翻译系统发布稳定版本V1.6，持续提高稳定性和翻译效率；系统态二进制翻译系统发布发行候选版本V1.4，建立较好的稳定性和效率基础。同时通过开源等方式进一步扩大技术辐射影响	提供对X86、ARM等原生应用的移植和支持，完善和丰富龙架构软件生态，支撑龙芯业务需求	国内领先水平
18	3号系列解决方案研发	不适用	957.06	21,925.95	主要解决方案已完成研制，并实现出货状态。拓展展开3A5000终端类高可靠应用解决方案的研发	基于龙芯系列芯片，开发面向终端和服务器的产品解决方案，其中终端类包括笔记本、台式机、一体机、云终端、自助机具等产品方案，服务器包括单、双、四路等低中高产	国内先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
						品方案	
19	2号系列解决方案研发	不适用	2,260.12	12,394.37	基于 2K2000、2K1500、3K0300 等多款解决方案完成研发,开始批量应用。多类型工控类解决方案的研发尚在进行中	基于龙芯系列 SoC 芯片,研发不同规格、功耗、应用场景的开发板或核心模块	国内先进水平
20	1号系列解决方案研发	不适用	7.89	3,982.55	基于 MCU 芯片研制的电机驱动等解决方案完成研发,准备量产出货	基于龙芯 MCU 芯片,开发具备高可靠性、高安全性、高扩展性行业解决方案,同时为合作伙伴提供相应的开发、测试工具,提高合作伙伴的行业竞争力	国内先进水平
21	教学实验箱解决方案研发	不适用	230.51	1,443.71	完成相关课程平台的研发,LA 教学相关实验产品实现小批量应用	基于龙芯芯片或者龙芯 IP 开发多款面向计算机类课程的教学实验设备	国内先进水平
22	3号系列第四代产品解决方案	不适用	6,460.02	14,090.41	包括 3C6000、3D6000、3E6000 等芯片在内的单路、双路、AI 服务器等解决方案全面展开并取得突破性进展	基于龙芯第四代系列芯片,开发面向终端和服务器的产品解决方案	国内先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
23	第二代行业专用解决方案	不适用	441.69	523.26	完成大口径流量表、蓝牙水表方案的开发,进入批量销售阶段。完成电机控制核心算法攻关,全面展开相关应用产品的研发	完成含电机控制、流量表、打印机等在内的第二代行业专用解决方案研制	国内先进水平
24	第四代工控产品解决方案	不适用	2,629.99	3,390.91	2K3000/3B6000M 笔记本方案完成研发,开始产品化验证;云终端解决方案完成研发,开始小批量出货;部分工控领域应用解决方案完成研发,开始小批量出货	完成含 2K3000 等在内的第四代工控解决方案研制	国内先进水平
25	第三代 GPGPU (结构升级) 芯片研发项目	不适用	168.26	168.26	完成规格定义和技术预研,正在推进方案设计	研制基于第三代 GPGPU 技术的 GPGPU 芯片产品,满足龙芯核心业务算力需求	国内先进水平
26	第五代桌面 CPU (结构升级) 及其配套芯片研发项目	不适用	4,237.09	4,237.09	第五代首款桌面 CPU 处理器龙芯 3B6600 基本完成设计; PCIe 接口精简型桥片龙芯 7A3000 代码齐套,全面展开设计	研制第五代桌面 CPU (结构升级) 及其配套芯片产品,持续提高桌面 CPU 竞争力	国内先进水平
27	第四代 CPU 安全可	不适用	3,760.33	3,760.33	龙芯 3A6000 高质量等级基	基于龙芯第四代系列	国内先进水

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
	靠提升项目				本完成产品化；开展“三剑客”高自主可控工艺迁移并开始样片摸底	CPU, 提高其安全可靠程度, 同时面向安全类应用开发高可靠产品	平
28	1X 纳米工艺平台建设和硬 IP 设计技术	不适用	145.7	145.7	完成 DDR5PHY 设计；完成自主工艺的设计迁移, 部分开始硅验证	完善基于 1X 纳米工艺实现芯片所需设计平台和各类硬 IP 建设	国内先进水平
29	第三代 GPGPU 核设计技术	不适用	87.1	87.1	LG300GPGPU 核基本完成方案设计, 开始全面推进正式设计	研制第三代 GPGPU 核, 支持更多功能、更高性能和更大规模的图形处理和通用计算	国内先进水平
30	X 纳米工艺平台建设和硬 IP 设计技术	不适用	109.82	109.82	初步建立 X 纳米工艺平台, 进行 RAM、PLL 等 IP 的研发	基于 X 纳米工艺, 建立和优化设计平台, 研制芯片产品所需各类硬 IP	国内先进水平
31	第五代服务器 CPU 及其配套芯片研制	不适用	223.39	223.39	以结构升级为主导, 开始第五代服务器 CPU 产品规格定义和技术预研	研制第五代服务器 CPU (结构升级) 及其配套芯片产品, 持续提高服务器 CPU 竞争力	国内先进水平
32	第五代嵌入式 CPU 研制	不适用	270.56	270.56	面向打印机主控中高端领域的系列化芯片产品, 基本完成规格定义和技术预研	研制针对打印机主控等多个专用领域的第五代嵌入式 CPU 产品	国内先进水平

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平
33	第六代 CPU 核设计技术	不适用	33.9	33.9	面向高性能领域的第六代 CPU 核，开始技术预研	研制第六代 CPU 核，追求效率、性能、性能面积比和性能功耗比等维度的持续提升	国内领先、国际先进水平
合计	/	/	<b>50,668.88</b>	<b>217,215.95</b>	/	/	/

## 2、知识产权

公司在各核心技术领域积极进行知识产权布局，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已获授权专利 869 项，其中发明专利 686 项，实用新型专利 180 项，外观设计专利 3 项。此外，公司还拥有软件著作权 205 项，集成电路布图设计专有权 32 项。

报告期内获得的知识产权列表如下所示：

知识产权类型	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	173	83	1248	686
实用新型专利	18	21	237	180
外观设计专利	1	1	3	3
软件著作权	4	0	209	205
其他	5	5	43	32
合计	201	110	1740	1106

注：表格中的“其他”是指集成电路布图设计

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序。2025 年，公司根据所处行业发展变化及公司发展战略、业务布局和实际生产经营的需要，结合募投项目的实施进度，经研究论证，拟将募投项目“先进制程芯片研发及产业化项目”、“高性能通用图形处理器芯片及系统研发项目”达到预定可

使用状态的时间由 2025 年 6 月调整至 2026 年 6 月，该事项已经公司董事会通过，并于 2025 年 4 月 29 日披露了《龙芯中科关于部分募集资金投资项目延期的公告（2025-009）》。

基于前述检查，保荐人未发现违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、审计委员会委员和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、审计委员会委员和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况如下：

2025 年度，公司控股股东未直接或间接发生减持行为，控股股东、实际控制人的一致行动人北京天童芯源投资管理中心（有限合伙）、北京天童芯正科技发展中心（有限合伙）、北京天童芯国科技发展中心（有限合伙）（以下合称“出让方”）系公司员工持股平台，2025 年 8 月，出让方因自身资金需求，通过询价转让方式合计转让 5,498,219 股，占总股本的比例为 1.37%。

2025 年度，公司董事、审计委员会委员、高级管理人员和核心技术人员不存在持股变动情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、审计委员会委员和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

## 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

2025 年度，随着过往三年研发转型成果逐步推向市场，公司产品竞争力不断提升。本年度，新一轮党政办公市场重启、安全应用市场恢复发展给公司带来新的商机，同时公司积极开拓非政策性市场，取得了有效进展。2025 年公司实现营业收入 63,532.06 万元，同比增长 25.99%。实现归属于上市公司股东的净利润-45,514.03 万元，仍然处于亏损状态，但同比减亏 17,020.28 万元，亏损收窄幅度为 27.22%。

保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（一）业绩大幅下滑或亏损的风险”对相关风险进行提示。未来，保荐人将督促公司做好信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司 2025 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

  
陈熙颖

  
何洋

